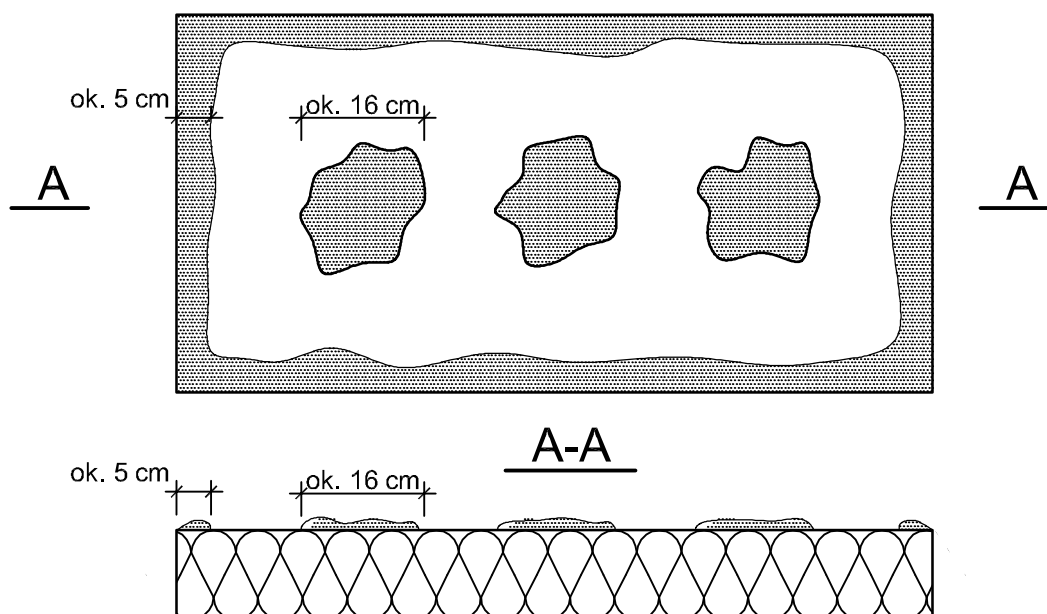
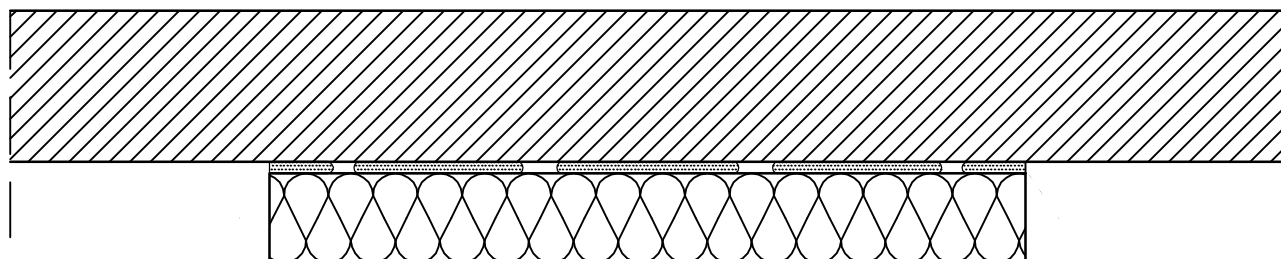


SPOSÓB KLEJENIA PŁYT IZOLACJI TERMICZNEJ



Uwagi!

Do klejenia izolacji termicznej używa się fabrycznie przygotowanych dyspresyjnych mas klejowych w przypadku podłożu nienasiąkliwych i drewnopochodnych lub zapraw klejowych do zmieszania z wodą na budowie w przypadku typowych podłoży budowlanych. Zaprawę klejową należy przygotować według zaleceń producenta (instrukcje/karty techniczne) również w przypadku fabrycznie przygotowanych klejów dyspresyjnych, które wymagają zmieszania z cementem celem przygotowania właściwej zaprawy klejowej. Klej należy nanosić na płyty izolacyjne według tzw. metody pasmowo-punktowej. Na płycie nanosić taką ilość zaprawy, aby uwzględniając odchyłki równości podłoża i możliwą do położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2cm) zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejania płyty do podłoża (przy większych nierównościach należy stosować zróżnicowane grubości izolacji). Po obwodzie płyty wzdłuż jej krawędzi należy nanieść około 5cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty nałożyć minimum 3 placki zaprawy wielkości dłoni. Na równych podłożach można nakładać zaprawę na płytę termoizolacyjną całościowo przy użyciu pasy zembatej (ok. 10mm).

Jednoczesne stosowanie materiałów różnych producentów jest niedopuszczalne!

 EKOPROBUD Firma a projektowo-wykonawcza		EkoProBud Biuro projektowe: 43-190 Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 65 tel. 509 527 540, www.ekoprobud.com.pl	
ADRES INWESTYCJI:		Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Janasa 13 41-700 Ruda Śląska	
TYTUŁ: PROJEKT DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO WIEŁORODZINNEGO PRZY UL. JANASA 13 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI			
TYTUŁ RYSUNKU:		SPOSÓB KLEJENIA PŁYT IZOLACJI TERMICZNEJ	
BRANŻA: ARCH.			
ARCHITEKTURA PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. L. Wiśniowski nr upr. 743/87	PODPIS:	02.2020
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Ł. Wengler nr. upr. 6/10/SLOKK	PODPIS:	SKALA: 1:10
OPRACOWAŁ:	inż. arch. Iwona Mandla	PODPIS:	NR RYS.
KIEROWNIK BIURA:	dr inż. T. Muzyczuk	PODPIS:	13